

上海韦尔半导体股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年6月5日起连续停牌，详情请见公司于2017年6月3日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）。2017年6月17日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-016），明确上述事项对公司构成重大资产重组。2017年7月5日公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-020），申请公司股票自2017年7月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2017年8月5日公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-027），申请公司股票自2017年8月5日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。

2017年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2017年8月26日，公司发布了《关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2017-040），并于2017年8月29日9:30-10:30以网络互动方式召开了重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通与交流，详情请查阅上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）及公司于2017年8月30日发布的《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-041）。

2017年9月4日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司与深圳市奥视嘉创股权投资合伙企业（有限合伙）、Seagull Holdings Hong Kong Limited、Seagull Holdings Cayman Limited等三十三位北京豪威现任股东共同签

署了《上海韦尔半导体股份有限公司重大资产重组框架协议》，具体内容详见公司 2017 年 9 月 5 日披露的《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2017-045）。

2016 年 9 月 4 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017 年 9 月 5 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2 个月。公司独立董事及独立财务顾问就继续停牌事项发表了核查意见。相关事项详见公司于 2017 年 9 月 5 日发布的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-046）。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告（公告编号：2017-021、2017-022、2017-023、2017-024、2017-029、2017-031、2017-034、2017-042）。

自公司停牌以来，截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在推进中，公司与有关各方对重组方案进行了进一步协商沟通，并协调独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构按照流程开展尽职调查等工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。

本次重大资产重组尚存在较大不确定性。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日